Amtsblatt
der Europäischen Union

DE
Reihe C

C/2024/4911

20.8.2024

MITTEILUNG DER KOMMISSION

über den Leitfaden zur Antragstellung für Unternehmen, die den Status einer integrierten Produktionsstätte oder eines offenen EU-Fertigungsbetriebs gemäß Artikel 15 der Verordnung (EU) 2023/1781 (Chip-Gesetz) anstreben

(C/2024/4911)

Inhalt

Buchseite

I. **Einleitung** ... 2

II. **„Neuartige Anlagen“** ... 3

1. **Definition des Begriffs „neuartig“** ... 3

2. **Definition der Begriffe „integrierte Produktionsstätte“ und „offener EU-Fertigungsbetrieb“** ... 3

3. **Vorteile, die mit dem Status als integrierte Produktionsstätte und offener EU-Fertigungsbetrieb verbunden sind** ... 4

A. Synergien mit staatlichen Beihilfen und Unterschiede dazu ... 5

B. Vorantragsphase ... 5

4. **Verpflichtungen, die mit dem IPF- und OEF-Status verbunden sind** ... 6

A. Krisenstufe ... 6

B. Vorrangige Aufträge ... 7

III. **Antrag auf den Status als integrierte Produktionsstätte oder offener EU-Fertigungsbetrieb** ... 8

1. **Wer kann den IPF- und OEF-Status beantragen?** ... 8

2. **Welche Anforderungen berücksichtigt die Kommission bei der Prüfung des Antrags?** ... 8

A. Neuartigkeit der Anlagen ... 8

B. Verpflichtung zur Einhaltung der in Artikel 13 Absatz 3 oder in Artikel 14 Absatz 3 des Chip-Gesetzes festgelegten Kriterien ... 9

C. Geschäftsplan (Artikel 15 Absatz 2 Buchstabe b des Chip-Gesetzes) ... 11

D. Dokumentation der Erfahrung des Antragstellers (Artikel 15 Absatz 2 Buchstabe c des Chip-Gesetzes) ... 11

E. Nachweis für die Bereitschaft des Mitgliedstaats bzw. der Mitgliedstaaten, auf dessen bzw. deren Hoheitsgebiet(en) die Anlage gebaut würde, ihre Einrichtung zu fördern (Artikel 15 Absatz 2 Buchstabe d des Chip-Gesetzes) ... 11

F. Vorliegen von politischen Maßnahmen und Plänen im Bereich des geistigen Eigentums (Artikel 15 Absatz 2 Buchstabe e des Chip-Gesetzes) ... 12

G. Verpflichtung zur vorrangigen Behandlung von Aufträgen in Krisenzeiten (Artikel 26 des Chip-Gesetzes) 12

3. **Nach welchem Verfahren bewertet die Kommission die Anträge?** ... 12

A. Antragseingang und erste Bewertungsstufe (Überprüfung des Online-Formulars) ... 12

B. Zweite Bewertungsstufe (Vollständigkeit des Antrags) ... 13

C. Dritte Bewertungsstufe (Einhaltung der Kriterien für den IPF- und OEF-Status) ... 13

D. Empfehlung des Europäischen Halbleitergremiums und Beschlussfassung ... 13

4. **Überwacht die Kommission nach Gewährung des IPF- oder OEF-Status die Durchführung des Projekts?** 14

A. Statusänderungen ... 14

B. Aufhebung des Status ... 14

5. **Wie funktioniert die elektronische Übermittlung des Antrags?** ... 15

IV. **Checkliste und IT-Werkzeuge** ... 16

A. Checkliste ... 16

B. IT-Werkzeuge für das Antragsverfahren ... 19

I. **Einleitung**

Diese Mitteilung (auch als „Leitfaden“ bezeichnet) enthält Leitlinien zum **Antragsverfahren für Unternehmen, die den Status einer integrierten Produktionsstätte (IPF) oder eines offenen EU-Fertigungsbetriebs (OEF)** gemäß Artikel 15 der **Verordnung (EU) 2023/1781 („Chip-Gesetz“)** [1] anstreben. Nach Artikel 15 des Chip-Gesetzes muss die Kommission Leitlinien über die erforderlichen Informationen und das entsprechende Format für die Beantragung des IPF- oder OEF-Status bereitstellen.

Das Chip-Gesetz trat am 21. September 2023 in Kraft und ist Teil eines umfassenderen Maßnahmenpakets zur Stärkung des Halbleiter-Ökosystems der EU [2].

Das Chip-Gesetz ist in drei Säulen gegliedert:

— Mit der Säule 1 wird die Initiative „Chips für Europa“ eingeführt, die den Aufbau von technologischen Kapazitäten und Innovationen in großem Maßstab in der gesamten EU unterstützen soll, um die Entwicklung und Einführung modernster Halbleiter- und Quantentechnik der nächsten Generation zu ermöglichen.

— **Mit der Säule 2 wird ein Rahmen zur Gewährleistung der Versorgungssicherheit und Resilienz geschaffen, der Investitionsanreize bieten und den Aufbau erweiterter Produktionskapazitäten** in den Bereichen Halbleiterfertigung, fortschrittliches Packaging, Prüfung und Montage fördern soll.

— Mit der Säule 3 wird ein Koordinierungsmechanismus zwischen den Mitgliedstaaten und der Kommission geschaffen, um die Zusammenarbeit mit und zwischen den Mitgliedstaaten bei der Überwachung und Krisenreaktion unter der Federführung des Europäischen Halbleitergremiums [3] zu stärken.

Im Rahmen der Säule 2 können **„neuartige“ Anlagen** (d. h. neue oder erheblich modernisierte Halbleiterfertigungsanlagen, die eine Dimension der Innovation schaffen, die es in der EU noch nicht gibt) den Status einer IPF oder eines OEF beantragen. Der Rahmen sieht Mittel und Wege vor, um die Einrichtung und den Betrieb solcher Anlagen in der EU zu erleichtern. Er erfordert aber auch die Einhaltung bestimmter Kriterien, damit sie einen Beitrag zur Erfüllung der Ziele der EU leisten und um ihre Zuverlässigkeit als Chipanbieter in Krisenzeiten zu gewährleisten.

Das vorliegende Dokument dient als Leitfaden für das Antragsverfahren zur Erlangung des IPF- und OEF-Status und ist wie folgt aufgebaut:

— In **Abschnitt II** wird der Begriff der „neuartigen Anlage“ in der EU vorgestellt und insbesondere erläutert, wie eine solche einzigartige Innovation für die Zwecke des Chip-Gesetzes nachgewiesen werden sollte (d. h. wie sie als IPF oder OEF anerkannt werden kann). In Abschnitt II werden auch die Vorteile und Synergien mit dem Verfahren zur Gewährung staatlicher Beihilfen sowie die Anforderungen des Chip-Gesetzes dargelegt, sobald der IPF- oder OEF-Status erlangt wurde.

— Der **Abschnitt III** enthält praktische Leitlinien für Unternehmen, wie sie den IPF- oder OEF-Status beantragen können und wie die Kommission solche Anträge bewertet. Insbesondere werden in Abschnitt III die Hauptschritte des Antragsverfahrens dargelegt, und es wird erläutert, wie die Antragsteller das Antragsformular, die Nachweise und die Verpflichtungszusagen einreichen sollten.

— Der **Abschnitt IV** enthält eine Checkliste für Unternehmen, in der alle wichtigen Aspekte aufgeführt sind, die bei der Vorbereitung der Anträge zu berücksichtigen sind, sowie technische Hinweise für die Benutzung der IT-Anwendungssysteme „Futurium“ und „S-CIRCABC“.

---

[1] Verordnung (EU) 2023/1781 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 13. September 2023 zur Schaffung eines Rahmens für Maßnahmen zur Stärkung des europäischen Halbleiter-Ökosystems und zur Änderung der Verordnung (EU) 2021/694 (Chip-Gesetz) (Text von Bedeutung für den EWR) (ABl. L 229 vom 18.9.2023, S. 1), PE/28/2023/INIT, (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2023.229.01.0001.01.DEU).

[2] Am 8. Februar 2022 nahm die Kommission ein Paket an, das Folgendes umfasste:
a. eine Mitteilung, in der die Gründe und die Gesamtstrategie für Halbleiter dargelegt werden, COM(2022) 45 final,
b. einen Vorschlag für eine Verordnung zur Stärkung des Halbleiter-Ökosystems der EU (Chip-Gesetz),
c. einen Vorschlag für Änderungen in einer Verordnung des Rates zur Gründung des Gemeinsamen Unternehmens für digitale Schlüsseltechnologien, COM(2022) 47 final,
d. eine Empfehlung an die Mitgliedstaaten zur Förderung von Maßnahmen zur Überwachung und Minderung von Störungen in der Halbleiter-Lieferkette, C(2022) 782 (ABl. L 35 vom 17.2.2022, S. 17).

[3] Das Europäische Halbleitergremium ist ein Leitungsgremium, das sich aus hochrangigen Vertretern der EU-Mitgliedstaaten zusammensetzt und durch die Artikel 28–30 des Chip-Gesetzes eingesetzt wurde. Das Europäische Halbleitergremium berät und unterstützt die Kommission und gibt ihr Empfehlungen nach Maßgabe des Kapitels V des Chip-Gesetzes.

II. **„Neuartige Anlagen“**

1. **Definition des Begriffs „neuartig“**

Wie bereits erwähnt, kann für **„neuartige“ Anlagen** der Status als **„integrierte Produktionsstätte“** oder als **„offener EU-Fertigungsbetrieb“** beantragt werden. Laut Artikel 2 Nummer 11 bezeichnet der Begriff „neuartige Anlage“ *„eine neue oder erheblich modernisierte Halbleiterfertigungsanlage* ([4]) *oder eine Anlage zur Herstellung von Ausrüstung oder Schlüsselkomponenten für solche Ausrüstung, die überwiegend in der Halbleiterfertigung verwendet werden, welche eine Innovation in Bezug auf das Fertigungsverfahren oder Endprodukt bietet, die im Wesentlichen in der Union noch nicht vorhanden ist oder noch nicht konkret geplant ist, einschließlich Innovationen, die Verbesserungen der Rechenleistung oder des Sicherheitsniveaus, der Gefahrenabwehr oder der Zuverlässigkeit oder der Energieeffizienz und Umweltbilanz oder des Technologieknotens oder Trägermaterials oder im Hinblick auf die Einführung von Produktionsverfahren, die Effizienzsteigerungen ermöglichen, betreffen oder die Rezyklierbarkeit verbessern oder Produktionsinputs verringern*“.

Damit eine Anlage als „neuartig“ angesehen werden kann, wird die Kommission prüfen, ob die Anlage eine Dimension der Innovation aufweist, die in der EU noch nicht vorhanden ist. Das Kriterium für die Einstufung als „neuartige Anlage“ ist, dass mit dieser ein innovatives Element in Bezug auf die Fertigungsprozesse oder das Endprodukt ([5]) in den Binnenmarkt eingeführt wird, das auf neuen oder bestehenden Technologieknoten beruhen könnte. Einschlägige Innovationselemente können sich auf den Technologieknoten oder das Trägermaterial oder auf Ansätze beziehen, die zu Verbesserungen bei der Rechenleistung oder anderen Leistungsmerkmalen, der Energieeffizienz, dem Sicherheitsniveau, der Gefahrenabwehr oder der Zuverlässigkeit sowie bei der Integration neuer Funktionen wie etwa bei der Speicherkapazität führen. Die Integration verschiedener Prozesse, die zu Effizienzsteigerungen führen, und die Automatisierung von Packaging und Montage sind ebenfalls Beispiele für Innovation. In Bezug auf Umweltvorteile können innovative Elemente eine quantifizierbare Verringerung des Energie-, Wasser- oder Chemikalienverbrauchs oder eine Verbesserung der Rezyklierbarkeit umfassen. Eine geeignete Bezugsquelle für die Ermittlung der Bereiche, in denen solche Innovationen stattfinden können, ist der Internationale Fahrplan für Geräte und Systeme (*International Roadmap for Devices and Systems*, IRDS) der IEEE, in dem wichtige technologische Trends in Bezug auf Geräte, Systeme und die damit zusammenhängende Technik aufgezeigt werden ([6]).

Definitionsgemäß **sollte die Fertigungsanlage** nicht nur innovativ sein, sondern auch eine **Innovationsfähigkeit aufweisen, die in der EU im Wesentlichen noch nicht vorhanden ist bzw. deren Aufbau noch nicht konkret geplant ist**. Das bedeutet, dass eine Fertigungsanlage, in der ein vergleichbares Produkt hergestellt, ein vergleichbarer Prozess durchgeführt oder eine vergleichbare Leistung in industriellem Maßstab erzielt werden kann, noch nicht bereits in der EU bestehen oder im Aufbau befindlich sein sollte. Wenn eine solche Innovation in der EU bereits in der FuE oder in der Kleinproduktion zum Einsatz kommt, würde dies aber nicht unbedingt ausschließen, dass eine entsprechende neue Massenfertigung als „neuartig“ eingestuft wird. So könnte beispielsweise eine Fertigungsanlage, in der die Verwendung eines neuartigen Trägermaterials geplant ist, in der EU als „neuartig“ eingestuft werden, obwohl dieses Trägermaterial bereits in einer Pilotanlage in einem Mitgliedstaat getestet wird. In diesem Zusammenhang ist zu beachten, dass nicht ausgeschlossen ist, mehrere parallele Projekte als „neuartig“ anzuerkennen, wenn keines von ihnen andere bestehende oder geplante private Tätigkeiten verdrängt und kein Risiko der Schaffung von Überkapazitäten besteht ([7]). Sowohl die Errichtung einer neuen Anlage als auch die Errichtung einer erheblich modernisierten Anlage kann zur Einstufung als „neuartige Anlage“ führen.

2. **Definition der Begriffe „integrierte Produktionsstätte“ und „offener EU-Fertigungsbetrieb“**

Um Investitionen in neue Produktionskapazitäten zu fördern und gleichzeitig dafür zu sorgen, dass sie der gesamten EU zugutekommen, wird durch Kapitel III des Chip-Gesetzes ein Rahmen für die Umsetzung von **zwei Arten „neuartiger Anlagen“** festgelegt. Diese beiden Arten spiegeln die beiden üblichen Geschäftsmodelle für den Betrieb von Halbleiterfertigungsanlagen in der heutigen Halbleiterindustrie wider und sind in den Artikeln 13 und 14 des Chip-Gesetzes festgelegt.

([4]) Laut Artikel 2 Nummer 15 bezeichnet der Begriff ‚Halbleiterfertigung‘ ‚jede der Stufen der Herstellung und Verarbeitung von Halbleiter-Wafern, einschließlich Trägermaterial, Front-End und Back-End, die erforderlich sind, um ein fertiges Halbleiterprodukt zu liefern‘.

([5]) Das Endprodukt befindet sich auf der Ebene der (potenziell gepackten) Halbleiter und nicht auf der Ebene des Geräts, in dem der Halbleiter verwendet wird.

([6]) Dieser beruht auf früheren Arbeiten am Internationalen Technologiefahrplan für Halbleiter (International Technology Roadmap for Semiconductors, ITRS), in dem auch die Bezugspunkte für die Prozessknoten (in Nanometern) festgelegt wurden, die sich aus der Entwicklung der Transistorskalierung nach der Vorhersage des Mooreschen Gesetzes ergeben. Der IRDS enthält derzeit Arbeiten verschiedener internationaler Schwerpunktteams auf folgenden Gebieten: *More Moore* (Skalierung), *More than Moore*, *Beyond CMOS*, Systeme und Architekturen, Packaging-Integration, Außersystemkonnektivität, kryogene Elektronik und Quanteninformationsverarbeitung, Lithografie, Ausbeutesteigerung, Metrologie, Fertigungsintegration, Umwelt, Sicherheit, Gesundheit und Nachhaltigkeit.

([7]) Mehrere parallele Projekte können als „neuartig“ anerkannt werden, wenn nachgewiesen werden kann, dass bestehende oder geplante private Tätigkeiten nicht durch staatlich geförderte Tätigkeiten verdrängt werden. Um übermäßige Wettbewerbsverzerrungen zu vermeiden, wird jede vorgeschlagene staatliche Beihilfe auf ihre etwaigen Vorteile hin geprüft. Dazu gehört auch eine eingehende Betrachtung der Notwendigkeit, Überkapazitäten zu vermeiden. Siehe Fußnote 56 der Mitteilung „Ein Chip-Gesetz für Europa“, COM(2022) 45.

— Laut Artikel 13 Absatz 1 des Chip-Gesetzes sind **integrierte Produktionsstätten** „*neuartige Anlagen für die Fertigung und gegebenenfalls auch den Entwurf von Halbleitern, oder für die Herstellung von Ausrüstung oder Schlüsselkomponenten für diese Ausrüstung, die überwiegend in der Halbleiterfertigung in der Union verwendet werden, was auch andere Stufen der Lieferkette einbeziehen kann, welche zur Versorgungssicherheit und zur Resilienz des Halbleiter-Ökosystems der Union beitragen; gegebenenfalls können sie zusätzlich zur Sicherheit der globalen Halbleiter-Lieferketten beitragen*". Mit anderen Worten, bei IPFs handelt es sich um integrierte Halbleiterfertigungsanlagen, die an der Front-End-Fertigung ([8]), an der Herstellung von Ausrüstung oder Schlüsselkomponenten für diese Ausrüstung, die überwiegend in der Halbleiterfertigung in der EU verwendet werden, sowie am Entwurf integrierter Schaltungen oder der Erbringung von Back-End-Dienstleistungen ([9]) oder beidem mitwirken.

— Laut Artikel 14 Absatz 1 des Chip-Gesetzes sind **offene EU-Fertigungsbetriebe** „*neuartige Anlagen oder Halbleiterfertigungsanlagen in der Union, die von ihnen unabhängigen Unternehmen Produktionskapazität anbieten und somit zur Versorgungssicherheit für den Binnenmarkt und zur Resilienz des Halbleiter-Ökosystems der Union beitragen; und gegebenenfalls können sie zusätzlich zur Sicherheit der globalen Halbleiter-Lieferkette beitragen*". Bei OEFs handelt es sich somit um Halbleiterfertigungsanlagen, die zumindest einen Teil ihrer Produktionskapazität zur Herstellung von Chips nach dem Entwurf anderer Unternehmen – insbesondere Unternehmen ohne eigene Fertigung – einsetzen.

3. Vorteile, die mit dem Status als integrierte Produktionsstätte und offener EU-Fertigungsbetrieb verbunden sind

Die Erlangung des IPF- oder OEF-Status bringt für die Unternehmen mehrere Vorteile mit sich.

a. Erstens sieht das Chip-Gesetz eine **gestraffte Bearbeitung der Verwaltungsanträge** vor. Mit diesen Bestimmungen sollen typische Hindernisse beim Aufbau großer Halbleiterfertigungsanlagen beseitigt werden, die aus dem langen Zeitraum erwachsen, den Projekte benötigen, um nötige Verwaltungsgenehmigungen zu erhalten, und komplexe und fragmentierte Genehmigungsverfahren zu durchlaufen. Nach Artikel 18 können Projekte, die den Status erlangt haben, von einer beschleunigten Bearbeitung ihrer Verwaltungsanträge profitieren, wie z. B. in Bezug auf Umweltverträglichkeitsprüfungen und Raumplanung. So kann ihnen Priorität eingeräumt werden, falls das nationale Verwaltungsrecht einen solchen Status bereits vorsieht.

Darüber hinaus ist im Chip-Gesetz festgelegt, dass die Sicherheit der Versorgung mit Halbleitern als zwingender Grund des überwiegenden öffentlichen Interesses im Sinne des Artikels 6 Absatz 4 und des Artikels 16 Absatz 1 Buchstabe c der Richtlinie 92/43/EWG ([10]) (Habitat-Richtlinie) und des Artikels 4 Absatz 7 der Richtlinie 2000/60/EG ([11]) (Wasserrahmenrichtlinie) angesehen werden kann. Unter außergewöhnlichen Umständen erlauben es diese Richtlinien, dass Projekte trotz negativer Umweltverträglichkeitsprüfung durchgeführt werden, wenn bestimmte Voraussetzungen erfüllt sind und ein zwingender Grund des überwiegenden öffentlichen Interesses vorliegt. In dieser Bestimmung des Chip-Gesetzes wird klargestellt, dass Planung, Bau und Betrieb von IPFs und OEFs unter solchen Umständen als von überwiegendem öffentlichem Interesse betrachtet werden können.

Nach Artikel 18 Absatz 4 können die Mitgliedstaaten zur Genehmigung von Anträgen und zur Verbesserung der Koordinierung des Verwaltungsverfahrens den Ansatz der „einzigen Anlaufstelle" verfolgen und eine Behörde benennen, die für die Erleichterung und Koordinierung von Verwaltungsanträgen im Zusammenhang mit der Planung, dem Bau und dem Betrieb solcher Anlagen zuständig ist. Dazu kann jede benannte Behörde einen Koordinator benennen, der als zentrale Anlaufstelle für die IPFs oder OEFs fungiert.

b. Zweitens können IPFs und OEFs **bevorzugten Zugang zu den Pilotanlagen erhalten, die im Rahmen der Initiative „Chips für Europa" (Säule 1 des Chip-Gesetzes) eingerichtet wurden**. Das bedeutet beispielsweise, dass ihre Anträge auf Nutzung der Pilotanlagen beschleunigt und bevorzugt behandelt werden könnten (ohne aber auszuschließen oder zu verhindern, dass auch anderen Interessenten ein effektiver Zugang gewährt wird).

([8]) „Front-End" bezeichnet die gesamte Verarbeitung eines Halbleiter-Wafers (Artikel 2 Nummer 16). Die Frontend-Fertigung von IPFs und OEFs kann einen oder alle Verarbeitungsschritte der Herstellung eines Halbleiter-Wafers umfassen, beginnend mit verschiedenen Trägermaterialien (Si, SiC, SOI usw.).

([9]) „Back-End" bezeichnet das Packaging, die Montage und die Prüfung jeder einzelnen integrierten Schaltung (Artikel 2 Nummer 17).

([10]) ABl. L 206 vom 22.7.1992, S. 7.

([11]) ABl. L 327 vom 22.12.2000, S. 1.

c. Drittens bedeutet die Zuerkennung des IPF- oder OEF-Status, dass eine Anlage **„neuartig" ist und zur Versorgungssicherheit in der EU beiträgt**. Die Kommission berücksichtigt dies unter anderem auch in einem möglichen **Beihilfeverfahren** gemäß Artikel 107 Absatz 3 Buchstabe c des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV), wie in der Mitteilung „Ein Chip-Gesetz für Europa" ([12]) angekündigt, wenn ein Mitgliedstaat vorschlägt, eine solche Anlage mit staatlichen Beihilfen zu unterstützen. Der Aspekt der „Neuartigkeit" nach dem Chip-Gesetz (Verordnung (EU) 2023/1781) und die beihilferechtliche Würdigung sind eng miteinander verknüpft. Die Kommission kann staatliche Beihilfen für die Einrichtung neuartiger Anlagen in der EU gestützt auf Artikel 107 Absatz 3 Buchstabe c AEUV genehmigen. Dieser Ansatz ergänzt die Leitlinien für wichtige Vorhaben von gemeinsamem europäischem Interesse (IPCEI) auf der Grundlage von Artikel 107 Absatz 3 Buchstabe b AEUV, mit denen länderübergreifende FuI-Projekte bis zur ersten industriellen Einführung in Bereichen von gemeinsamem Interesse gefördert werden sollen, wodurch eine andere Phase des Innovationszyklus unterstützt wird. Auch wenn der Wortlaut des Chip-Gesetzes (Verordnung (EU) 2023/1781) die Anwendung der Artikel 107 und 108 AEUV unberührt lässt, werden die Kommissionsdienststellen bei der beihilferechtlichen Prüfung die Anerkennung der „Neuartigkeit" bei Projekten mit berücksichtigen.

A. *Synergien mit staatlichen Beihilfen und Unterschiede dazu*

Es kann vorkommen, dass ein Mitgliedstaat beabsichtigt, ein Projekt, das den IPF- oder OEF-Status beantragt, zusätzlich auch mit staatlichen Beihilfen zu unterstützen. Hier ist zu betonen, dass die **Beantragung des IPF- oder OEF-Status ein von der beihilferechtlichen Prüfung getrenntes Verfahren** ist. **Für diese beiden Verfahren können daher unterschiedliche Arten von Informationen benötigt werden.**

Das Antragsverfahren für den IPF- und OEF-Status soll sicherstellen, dass die Anlage des antragstellenden Unternehmens der Definition entspricht und die damit verbundenen Bedingungen des Artikels 13 bzw. des Artikels 14 des Chip-Gesetzes erfüllt, und muss vom antragstellenden Unternehmen durchgeführt werden. Dagegen wird das Beihilfeverfahren durch die Anmeldung eines Mitgliedstaats eingeleitet und beinhaltet eine umfassendere rechtliche und wirtschaftliche Prüfung der öffentlichen Unterstützung, die dem antragstellenden Unternehmen gewährt werden soll. Zudem erfolgt die Prüfung auf der Grundlage einer Reihe kumulativer Voraussetzungen nach Artikel 107 Absatz 3 Buchstabe c AEUV, damit die Maßnahme der Wirtschaftstätigkeit zugutekommt, die sie erleichtern soll, und die Handelsbedingungen nicht in einer Weise verändert, die dem gemeinsamen Interesse zuwiderläuft.

Falls eine öffentliche Unterstützung in Form staatlicher Beihilfen geplant ist, sollten die Unternehmen, die den IPF- und OEF-Status beantragen möchten, und die betreffenden Mitgliedstaaten **der Kommission die Einleitung dieser beiden Verfahren gleichzeitig mitteilen**.

Ebenso sollten Antragsteller, die den IPF- oder OEF-Status beantragen möchten und bereits ein Beihilfeverfahren eingeleitet oder abgeschlossen haben, ihren IPF- oder OEF-Antrag so bald wie möglich einreichen und **im Antragsformular auf die betreffende staatliche Beihilfe verweisen**. Antragsteller, die sich um den IPF- oder OEF-Status bemühen und im Besitz einschlägiger Unterlagen sind, die der anmeldende Mitgliedstaat im Rahmen des Beihilfeverfahrens eingereicht hat, werden von den Kommissionsdienststellen dazu ermuntert, bei ihrer separaten IPF- oder OEF-Beantragung **solche Unterlagen und Beschreibungen weiterzuverwenden**, sofern sie zur Verwendung dieser Unterlagen berechtigt sind (siehe auch Abschnitt III.2). Ebenso können Antragsteller, die den IPF- oder OEF-Status anstreben, im Einvernehmen mit dem anmeldenden Mitgliedstaat und mit dessen Hilfe die bei der IPF- oder OEF-Beantragung eingereichten Unterlagen auch in dem Beihilfeverfahren möglichst weiterverwenden. Nach Möglichkeit werden nämlich **beide Verfahren und die jeweiligen Prüfungen parallel zueinander durchgeführt**. Die jeweils zuständigen Kommissionsdienststellen werden in engem Kontakt stehen, um die Einhaltung der Kriterien für IPFs bzw. OEFs bestmöglich zu koordinieren, die Entscheidungsfindung zu beschleunigen und zusätzliche Belastungen für die Antragsteller zu vermeiden. Außerdem werden sich die zuständigen Kommissionsdienststellen darum bemühen, gleichzeitig hierüber zu entscheiden. Der Zeitrahmen hängt jedoch von der Vollständigkeit der vom Antragsteller und vom Mitgliedstaat bzw. den Mitgliedstaaten übermittelten Informationen sowie von den Gegebenheiten des geprüften Einzelfalls ab.

B. *Vorantragsphase*

Die Erfahrungen der Kommission mit Beihilfeverfahren zeigen den Mehrwert von Vorabkontakten ([13]), die es der Kommissionsdienststelle und dem anmeldenden Mitgliedstaat ([14]) ermöglichen, die rechtlichen und wirtschaftlichen Aspekte eines geplanten Projekts schon vor der Anmeldung informell und vertraulich zu erörtern und dadurch die Qualität und Vollständigkeit der Anmeldungen zu verbessern. In diesem Zusammenhang können der Mitgliedstaat und die Kommissionsdienststelle auch gemeinsam konstruktive Vorschläge zur Behebung problematischer Aspekte einer geplanten Beihilfemaßnahme ausarbeiten. Diese Phase bietet die Möglichkeit, die Bearbeitung von Anmeldungen zu beschleunigen, sobald sie dann förmlich bei der Kommission eingereicht wurden. Nach Ansicht der Kommission können diese Erwägungen sinngemäß auch auf das Antragsverfahren für den IPF- oder OEF-Status in Form einer „Vorantragsphase" übertragen werden.

([12]) Mitteilung der Kommission vom 8. Februar 2022, COM(2022) 45 final. Die Mitteilung liegt in allen EU-Amtssprachen vor.

([13]) Verhaltenskodex für die Durchführung von Beihilfeverfahren, abrufbar unter https://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/best_practices_code_en.pdf (auf Englisch).

([14]) In Beihilfeverfahren können (Vor-)Anmeldungen nur von dem bzw. den betreffenden Mitgliedstaat(en) eingereicht werden.

Die **Vorantragsphase** bietet dem Antragsteller die Gelegenheit, die Sache mit der Kommission zu erörtern und Hinweise dazu zu erhalten, wie er sicherstellen kann, dass er alle erforderlichen Informationen einreicht. Eine fruchtbare Vorantragsphase erleichtert auch das Verständnis aller wesentlichen Probleme, die sich aus einem geplanten Projekt ergeben. **Die Vorantragsphase ist aber nicht zwingend vorgeschrieben.** Unternehmen können eine Vorantragsphase insbesondere dann in Betracht ziehen, wenn ihre Projekte spezielle Elemente oder Besonderheiten aufweisen, bei denen informelle Vorgespräche mit den Kommissionsdienststellen hilfreich wären.

Um eine konstruktive und effiziente Vorantragsphase zu ermöglichen, liegt es im Interesse des Antragstellers, der Kommission alle Informationen zu übermitteln, die diese benötigt, um das geplante Projekt anhand eines Antragsentwurfs prüfen zu können. Zur Erleichterung einer raschen Antragsbearbeitung sind Vorabkontakte per E-Mail, Telefonkonferenz usw. grundsätzlich persönlichen Sitzungen vorzuziehen.

Vorabkontakte sollten nicht länger als zwei Monate dauern und streng vertraulich sein, um eine **unverbindliche** und informelle eine Orientierung seitens der Kommissionsdienststelle zu ermöglichen und so das anschließende förmliche Antragsverfahren zu erleichtern.

In dieser Phase wird **die Kommission daher keine förmliche oder offizielle Bewertung vornehmen**. **Von den Unternehmen wird insbesondere auch nicht erwartet, dass sie** eine der mit dem IPF- und OEF-Status verbundenen Verpflichtungen eingehen.

4. **Verpflichtungen, die mit dem IPF- und OEF-Status verbunden sind**

Zusätzlich zu den Verpflichtungen, die eingegangen werden, um den IPF- oder OEF-Status beantragen zu können (und deren tatsächliche Umsetzung von der Kommission überwacht wird, Näheres dazu in Abschnitt III), gilt für Unternehmen mit **IPF- oder OEF-Status auch der Artikel 26** des Chip-Gesetzes. In diesem Artikel heißt es: „*Wird die Krisenstufe gemäß Artikel 23 aktiviert, so kann die Kommission integrierte Produktionsstätten und offene EU-Fertigungsbetriebe dazu verpflichten,* ***einen Auftrag über krisenrelevante Produkte anzunehmen und vorrangig zu behandeln (im Folgenden ‚vorrangiger Auftrag')***“.

Sowohl für die Aktivierung der **Krisenstufe** als auch für den Rückgriff auf **vorrangige Aufträge als „letztes Mittel“ gibt es sehr spezifische Kriterien und Voraussetzungen**, die gewährleisten, dass solche Aufträge **notwendig und verhältnismäßig** sind.

A. *Krisenstufe*

Die Halbleiter-Krisenstufe sollte nur aktiviert werden, wenn konkrete, schwerwiegende und zuverlässige Belege für eine solche Krise vorliegen. Eine Halbleiterkrise würde eintreten, wenn schwerwiegende Störungen der Versorgung mit Halbleitern oder schwerwiegende Hemmnisse für den Handel mit Halbleitern in der EU bestehen, die zu erheblichen Versorgungsengpässen bei Halbleitern, Zwischenprodukten oder Rohstoffen oder verarbeiteten Werkstoffen führen, und wenn diese erheblichen Versorgungsengpässe die Bereitstellung, Reparatur und Wartung wesentlicher Produkte, die von kritischen Sektoren ([15]) verwendet werden, z. B. medizinischer und diagnostischer Ausrüstung, in einem Ausmaß verhindern, dass das Funktionieren der kritischen Sektoren aufgrund ihrer Auswirkungen auf Gesellschaft, Wirtschaft und Sicherheit der EU ernsthaft beeinträchtigt würde. Die Krisenstufe würde im Wege eines Durchführungsrechtsakts des Rates ausgerufen. **Wenn eine Krisenstufe ausgerufen wird und es zur Bewältigung einer Halbleiterkrise in der EU erforderlich ist**, kann die Kommission ausnahmsweise dazu ermächtigt werden, bestimmte Notfallmaßnahmen zu ergreifen, die in einem im Chip-Gesetz festgelegten **Notfallinstrumentarium** vorgesehen sind. Die Durchführung einer solchen Maßnahme erfolgt nach einem Dialog mit dem Europäischen Halbleitergremium ([16]) und nur insoweit, wie dies im Einklang mit den internationalen Verpflichtungen der EU erforderlich, angemessen und verhältnismäßig ist.

([15]) Kritische Sektoren sind in Anhang IV des Chip-Gesetzes aufgeführt. Dazu gehören: Energie, Verkehr, Banken, Finanzmarktinfrastruktur, Gesundheit, Trinkwasser, Abwasser, digitale Infrastruktur, öffentliche Verwaltung, Raumfahrt, Produktion, Verarbeitung und Vertrieb von Lebensmitteln, Verteidigung, Sicherheit.

([16]) Siehe Fußnote 5 des vorliegenden Leitfadens und die Artikel 28–30 des Chip-Gesetzes.

Das Notfallinstrumentarium besteht aus mehreren Instrumenten:

— **Informationsersuchen** (Artikel 25): Um das Verständnis der Störungen der Lieferkette zu verbessern und die Entscheidungsfindung zur Bewältigung einer Krise zu ermöglichen, ermächtigt das Chip-Gesetz die Kommission zu verbindlichen Informationsersuchen in Bezug auf Produktionsvermögen und Produktionskapazitäten, derzeitige Hauptstörungen sowie andere vorhandene Daten, die benötigt werden, um die Art der Krise zu beurteilen oder möglicherweise zu ergreifende Risikominderungs- oder Notfallmaßnahmen zu ermitteln und zu bewerten.

— **Vorrangige Aufträge** (Artikel 26): siehe Abschnitt B.

— **Gemeinsame Beschaffung** (Artikel 27): Als zusätzliches Instrument für die Zuweisung von Ressourcen für vorrangige Bereiche sieht das Chip-Gesetz einen Rahmen für die gemeinsame Beschaffung krisenrelevanter Produkte vor.

Außerdem kann das Europäische Halbleitergremium in Bezug auf die Notwendigkeit der Einführung von Schutzmaßnahmen gemäß der Verordnung (EU) 2015/479 des Europäischen Parlaments und des Rates ([17]) beraten (z. B. in Bezug auf Ausfuhrgenehmigungen).

B. *Vorrangige Aufträge*

Um den Mangel an Instrumenten zu beheben, die während eines Engpasses in besonders gefährdeten kritischen Sektoren eine angemessene Ressourcenzuweisung in der EU erlauben, sieht das Chip-Gesetz eine Verpflichtung von IPFs und OEFs zur vorrangigen Behandlung vor. Diese Verpflichtung zur vorrangigen Behandlung beinhaltet eine durchsetzbare Pflicht zur Annahme und vorrangigen Behandlung einer Bestellung für krisenrelevante Produkte.

Diese **Verpflichtung kann ggf. auch anderen Halbleiterunternehmen auferlegt werden**, die diese Möglichkeit im Rahmen des **Erhalts öffentlicher Unterstützung** akzeptiert haben. Darüber hinaus müssen in der EU niedergelassene Halbleiterunternehmen gemäß Artikel 26 Absatz 3 **die Kommission informieren**, wenn ihnen **ein vorrangiger Auftrag eines Drittlands auferlegt** wird. Wenn sich diese Verpflichtung erheblich auf das Funktionieren bestimmter kritischer Sektoren auswirkt, kann die Kommission, sofern dies erforderlich und verhältnismäßig ist, von solchen Unternehmen verlangen, dass sie Aufträge für krisenrelevante Produkte annehmen und vorrangig behandeln.

Vorrangige Aufträge sind beschränkt auf Begünstigte, die Halbleiter in kritischen Sektoren verwenden, sowie auf Unternehmen, die kritische Sektoren beliefern, deren Tätigkeiten gestört sind oder gestört zu werden drohen und die nach Ergreifung geeigneter Risikominderungsmaßnahmen nicht in der Lage sind, die Auswirkungen des Engpasses durch andere Mittel zu vermeiden und abzufedern. Die Kommission kann einen Begünstigten auffordern, dies mit geeigneten Nachweisen zu belegen.

Diese Verpflichtung kann durch einen an das einzelne Unternehmen gerichteten **Beschluss der Kommission** nach Prüfung der besonderen Umstände des Falles und nur dann auferlegt werden, wenn dies unter Berücksichtigung der legitimen Ziele des Unternehmens sowie der Kosten und des Aufwands, die durch eine Änderung der Produktionsfolge entstehen, erforderlich und verhältnismäßig ist. In dem Beschluss der Kommission werden das Produkt, die Menge und die Frist festgelegt. Ein solcher vorrangiger Auftrag muss zu einem **fairen und angemessenen Preis** vergeben werden. Im Gegenzug wird Unternehmen, die einen vorrangigen Auftrag erfüllen, bei Verstößen gegen vertragliche Verpflichtungen, die zur Erfüllung eines solchen Auftrags erforderlich sind, ein **Haftungsschutz** gewährt. Die Kommission erlässt dann einen Durchführungsrechtsakt zur Festlegung der näheren praktischen und operativen Modalitäten für die Funktionsweise vorrangiger Aufträge (Artikel 26 Absatz 8).

In Artikel 26 Absatz 6 des Chip-Gesetzes heißt es: *„Vor der Erteilung vorrangiger Aufträge … gibt die Kommission dem vorgesehenen Empfänger eines vorrangigen Auftrags Gelegenheit, sich zur Durchführbarkeit und zu den Einzelheiten des Auftrags zu äußern.* ***Die Kommission erteilt den vorrangigen Auftrag nicht, wenn***

a. das Unternehmen wegen unzureichenden Produktionsvermögens oder wegen unzureichender Produktionskapazität oder aus technischen Gründen nicht in der Lage ist, den vorrangigen Auftrag zu erfüllen, selbst wenn es diesen Auftrag vorrangig behandelt;

b. die Annahme des Auftrags eine unzumutbare wirtschaftliche Belastung und eine besondere Härte für das Unternehmen darstellen würde, einschließlich erheblicher Risiken im Zusammenhang mit der Betriebskontinuität."

([17]) Verordnung (EU) 2015/479 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 11. März 2015 über eine gemeinsame Ausfuhrregelung (ABl. L 83 vom 27.3.2015, S. 34).

Sobald der Antragsteller den IPF- oder OEF-Status erlangt hat, ist er **rechtlich verpflichtet, die Bestimmungen** des Chip-Gesetzes **über die vorrangige Behandlung von Aufträgen** in Krisenzeiten **einzuhalten**. Die Kommission wird von den Unternehmen während des Antragsverfahrens eine ausdrückliche Anerkennung dieser Verpflichtung verlangen.

III. **Antrag auf den Status als integrierte Produktionsstätte oder offener EU-Fertigungsbetrieb**

Der folgende Abschnitt enthält eine Reihe von **Fragen und Antworten** (nach Maßgabe des Artikels 15 des Chip-Gesetzes). Er dient Antragstellern als Orientierungshilfe für **das Antragsverfahren, die erforderlichen Unterlagen und das geeignete Format** und ergänzt das Antragsformular und die Checkliste in Abschnitt IV.

Dieser Leitfaden beruht auf den laufenden Erfahrungen der Kommissionsdienststellen mit der Beantragung des IPF- oder OEF-Status im Rahmen des Chip-Gesetzes. Dieser Leitfaden trägt auch der Rechtsprechung des Gerichtshofs und des Gerichts Rechnung. Die Kommission kann diesen Leitfaden in Anbetracht künftiger Entwicklungen und neuer Erkenntnisse überarbeiten.

Die Analyse der Anträge auf den IPF- oder OEF-Status lässt die Auslegung des Chip-Gesetzes durch den Gerichtshof oder das Gericht unberührt. Die Kommission verpflichtet sich, alle Informationen, die sie in einem Antrag auf Anerkennung als IPF oder OEF erlangt, mit größter Vertraulichkeit zu behandeln und solche Informationen, die unter das Berufsgeheimnis gemäß Artikel 339 AEUV fallen und den internen Vorschriften der Kommission über den sicheren Umgang mit Daten – insbesondere dem Beschluss (EU, Euratom) 2015/443 der Kommission ([18]) – unterliegen, ausschließlich für die Zwecke des Chip-Gesetzes zu verwenden.

1. **Wer kann den IPF- und OEF-Status beantragen?**

Nach Artikel 15 Absatz 1 des Chip-Gesetzes kann „***jedes Unternehmen oder Unternehmenskonsortium … bei der Kommission einen Antrag darauf stellen****, einem Projekt den Status als integrierte Produktionsstätte oder offener EU-Fertigungsbetrieb zu gewähren*“. Um diesen Status zu erhalten, müssen sie jedoch bestimmte Kriterien erfüllen (siehe Antwort auf Frage 2).

2. **Welche Anforderungen berücksichtigt die Kommission bei der Prüfung des Antrags?**

Bei der Prüfung eines Antrags vergewissert sich die Kommission, dass eine Reihe von Anforderungen erfüllt werden und bestimmte Unterlagen eingereicht worden sind (siehe unten).

Bitte beachten Sie, dass die im Rahmen des Genehmigungsverfahrens für staatliche Beihilfen vorgelegten Unterlagen auch für die Prüfung von Anträgen auf den IPF- oder OEF-Status hilfreich sind. Antragsteller, die den IPF- oder OEF-Status anstreben und an einem Beihilfeverfahren beteiligt sind oder dieses bereits abgeschlossen haben, sollten im Antragsformular **auf die betreffende staatliche Beihilfe verweisen**. Antragsteller, die den IPF- oder OEF-Status anstreben und im Besitz einschlägiger Unterlagen sind, die der anmeldende Mitgliedstaat im Rahmen des Beihilfeverfahrens eingereicht hat, werden von den Kommissionsdienststellen dazu ermuntert, bei ihrer separaten IPF- oder OEF-Beantragung **solche Unterlagen und Beschreibungen weiterzuverwenden**, sofern sie zur Verwendung dieser Unterlagen berechtigt sind. Alternativ dazu können antragstellende Unternehmen auch eine Genehmigung des anmeldenden Mitgliedstaats vorlegen, dass bestimmte Unterlagen, die im Zusammenhang mit der Anmeldung staatlicher Beihilfen eingereicht wurden, auch für das Antragsverfahren verwendet werden dürfen. Solche konkret genannten Unterlagen brauchen dann nicht erneut eingereicht zu werden. Ebenso können Antragsteller, die den IPF- oder OEF-Status anstreben, im Einvernehmen mit dem anmeldenden Mitgliedstaat und mit dessen Hilfe die bei der IPF- oder OEF-Beantragung eingereichten Unterlagen auch in dem Beihilfeverfahren möglichst weiterverwenden. Dies gilt für alle im Antrag auf den IPF- und OEF-Status geprüften Kriterien, soweit die im Beihilfeverfahren verwendeten Unterlagen und Beschreibungen zum Nachweis der Einhaltung der nachstehend beschriebenen Kriterien und Anforderungen herangezogen werden können. Ist dies nicht der Fall, müssen neue Unterlagen und Nachweise oder entsprechende Ergänzungen eingereicht werden.

A. *Neuartigkeit der Anlagen*

Die Kommission prüft zuerst, ob es sich um eine **„neuartige“ Anlage** handelt (Nummer 1 des Antragsformulars), wie in Artikel 13 Absatz 2 bzw. Artikel 14 Absatz 2 des Chip-Gesetzes gefordert.

([18]) Beschluss (EU, Euratom) 2015/443 der Kommission vom 13. März 2015 über Sicherheit in der Kommission (ABl. L 72 vom 17.3.2015, S. 41).

Der Antragsteller muss das Projekt entsprechend der Begriffsbestimmung für „neuartig“ beschreiben. Falls bereits ein beihilferechtlicher Beschluss vorliegt, in dem die Neuartigkeit der Anlage anerkannt wird, so wird diese Anerkennung in das Verfahren nach dem Chip-Gesetz übernommen. Insbesondere sollte der Antragsteller angeben, welche Innovationselemente, die in der EU noch nicht vorhanden oder noch nicht konkret geplant sind, der Fertigungsprozess oder das Endprodukt seiner Anlage für den Binnenmarkt bringen wird. Der Antragsteller sollte erläutern, worin sich sein Projekt von bestehenden Anlagen und – soweit bekannt – von anderen geplanten Projekten (mit oder ohne öffentliche Unterstützung) in der EU unterscheidet.

Der Antragsteller sollte Nachweise aus öffentlichen Quellen oder Marktkenntnisse über bestehende oder geplante Anlagen, die ähnliche Technologien nutzen, vorlegen und ausführlich erläutern, inwiefern diese sich von denen des Antragstellers unterscheiden.

Die Erläuterung sollte **5 000 Zeichen (rund drei Seiten) nicht überschreiten**. **Nachweise können in S-CIRCABC in den Ordner „01-First-of-a-kind“ hochgeladen werden.**

Zu den Unterlagen, die für den Nachweis der „Neuartigkeit“ der Anlage von Bedeutung sein könnten, gehören Marktstudien und Berichte über die Geschäftstätigkeit und die Produkte der Anlage, interne Projektdokumentationen und/oder Unterlagen, die der Verwaltungsrat für seine interne Entscheidungsfindung verwendet. Siehe auch Abschnitt II des vorliegenden Leitfadens.

B. *Verpflichtung zur Einhaltung der in Artikel 13 Absatz 3 oder in Artikel 14 Absatz 3 des Chip-Gesetzes festgelegten Kriterien*

Zweitens fordert die Kommission den Antragsteller unter Nummer 2 des Antragsformulars auf, sich zur Erfüllung der in Artikel 13 Absatz 3 bzw. Artikel 14 Absatz 3 des Chip-Gesetzes **festgelegten Kriterien für eine IPF oder ein OEF zu verpflichten**. Dabei geht es um folgende Kriterien:

(a) *Positive Auswirkungen* (Nummer 2.1 des Antragsformulars): Das Unternehmen muss nachweisen, dass die Einrichtung mittel- bis langfristig eindeutig positive Auswirkungen auf die Halbleiter-Wertschöpfungskette der Union mit Ausstrahlungseffekten über das Unternehmen oder den betreffenden Mitgliedstaat hinaus im Hinblick darauf hat, die Versorgungssicherheit und Resilienz des Halbleiter-Ökosystems (einschließlich des Wachstums von Start-ups und KMU) sicherzustellen, und zum grünen und digitalen Wandel der Union beiträgt.

Die Erläuterung sollte **5 000 Zeichen (rund drei Seiten) nicht überschreiten**.

Mögliche Ausstrahlungseffekte werden von Fall zu Fall geprüft.

In Erwägungsgrund 34 des Chip-Gesetzes werden verschiedene Maßnahmen zur Erzielung positiver Auswirkungen beschrieben, die vom Antragsteller für die Zwecke der Einstufung seiner Anlage als IPF oder OEF erwogen werden können. Beispiele hierfür sind:

— die Gewährung des Zugangs zu Fertigungsanlagen für Dritte gegen eine marktübliche Gebühr,

— die Bereitstellung von Process-Design-Kits für kleinere Entwurfsunternehmen oder für die virtuelle Entwurfsplattform (Artikel 5 des Chip-Gesetzes),

— die Verbreitung von Ergebnissen ihrer FuE-Tätigkeiten,

— die Forschungszusammenarbeit mit europäischen Universitäten und Forschungsinstituten,

— die Zusammenarbeit mit nationalen Behörden oder Bildungs- und Berufsbildungseinrichtungen, um zur Kompetenzentwicklung beizutragen,

— der Beitrag zu EU-weiten Forschungsprojekten oder

— das Angebot spezieller Unterstützungsmöglichkeiten für Start-ups und KMU.

Auswirkungen, die sich auf mehrere Mitgliedstaaten erstrecken, auch in Bezug auf Kohäsionsziele, sollten als einer der Indikatoren für eindeutig positive Auswirkungen einer IPF bzw. eines OEF auf die Halbleiter-Wertschöpfungskette in der EU betrachtet werden.

Nur für offene EU-Fertigungsbetriebe ([19]): Die Kommission wird berücksichtigen, inwieweit der Antragsteller von der Anlage unabhängigen Unternehmen Produktionskapazität im Front-End- und/oder Back-End-Bereich anbietet, sofern eine ausreichende Nachfrage besteht.

([19]) Artikel 14 Absatz 3 Buchstabe a.

(b) *Gewähr dafür, dass der Antragsteller nicht der extraterritorialen Anwendung gemeinwirtschaftlicher Verpflichtungen von Drittländern unterworfen ist* (Nummer 2.2 des Antragsformulars): Der Antragsteller muss zusichern, dass er nicht der extraterritorialen Anwendung gemeinwirtschaftlicher Verpflichtungen von Drittländern unterworfen wird, die seine Fähigkeit beeinträchtigen könnten, seine Infrastruktur, Software, Dienste, Anlagen, Vermögenswerte oder Ressourcen, sein geistiges Eigentum oder seine Fachkenntnisse zu nutzen, die er zur Erfüllung der Verpflichtung benötigt, vorrangige Aufträge gemäß dieser Verordnung auszuführen. Außerdem verpflichtet sich der Antragsteller, die Kommission darüber zu unterrichten, wenn sich eine solche Verpflichtung ergibt.

Wenn bei einer IPF oder einem OEF abzusehen ist, dass sie bzw. es einer gemeinwirtschaftlichen Verpflichtung eines Drittlands sowie einer konkurrierenden Verpflichtung seitens der Kommission unterworfen sein wird, muss die Produktionskapazität so organisiert und sequenziert werden, dass sichergestellt ist, dass die von der Kommission auferlegten Verpflichtungen erfüllt werden können.

Eine solche Zusicherung könnte beispielsweise in einer schriftlichen Erklärung gegeben werden und müsste eine Verpflichtung enthalten, die Kommission zu unterrichten, wenn ein solcher Fall eintritt.

Die Erläuterung sollte **5 000 Zeichen (rund drei Seiten) nicht überschreiten**.

Der Nachweis, dass ein Unternehmen nicht der extraterritorialen Anwendung gemeinwirtschaftlicher Verpflichtungen von Drittländern unterworfen ist, sollte in S-CIRCABC in den Ordner „02-IPF-OEF compliance criteria“ hochgeladen werden.

Zu den Verpflichtungen, von denen die Kommission zu unterrichten ist, zählen alle anderen vorrangigen Aufträge, die das Unternehmen aus Nicht-EU-Ländern annimmt, oder Verpflichtungen, denen das Unternehmen aufgrund von Rechtsvorschriften oder Verträgen unterliegt, wonach es einen öffentlichen Dienst in einem Nicht-EU-Land erbringen muss, wenn dies die Fähigkeit des Unternehmens, seinen Verpflichtungen aus dem Chip-Gesetz nachzukommen, beeinträchtigen oder dieser entgegenstehen könnte.

(c) *Investitionen in die kontinuierliche Innovation* (Nummer 2.3 des Antragsformulars): Das Unternehmen muss zusagen, in kontinuierliche Innovation zu investieren, um konkrete Fortschritte im Bereich der Halbleitertechnologie zu erzielen oder Technologien der nächsten Generation vorzubereiten.

Die Erläuterung sollte **5 000 Zeichen (rund drei Seiten) nicht überschreiten**.

Eine solche Verpflichtung könnte beispielsweise darin bestehen, zur Umsetzung der Säule 1 des Chip-Gesetzes beizutragen, indem Kenntnisse und Kompetenzen für die Vorbereitung von Pilotanlagen bereitgestellt werden, deren Entwicklung aufmerksam verfolgt wird und zu denen beigetragen wird. Die Verpflichtung könnte auch darin bestehen, in ihren Anlagen eine Vorproduktionsanlage zu errichten, um die Ergebnisse der Pilotanlage vom Labor (z. B. von der Forschungs- und Technologieorganisation) in die Fertigung zu überführen. Dieser Verpflichtung könnte durch die Planung von Investitionen in fortgeschrittene Technologieknoten (z. B. Verbesserung der Rechenleistung und der Energieeffizienz) nachgekommen werden, durch die etwa ein Beitrag zur Vorbereitung von Pilotanlagen oder Vorproduktionsanlagen am Standort geleistet wird. Der Antragsteller sollte erläutern, inwiefern die Anlage schwerpunktmäßig Innovationen in der EU hervorbringt sowie konkrete Fortschritte in der Halbleitertechnologie erzielt und/oder Technologien und Halbleiter der nächsten Generation vorbereitet.

Es ist wichtig, dass das Unternehmen darlegt, wie es beabsichtigt, kontinuierliche Innovationen zu erzielen (z. B. durch die Angabe jährlicher Investitionen in FuE oder durch Festlegung konkreter Meilensteine auf dem Weg zur Einführung neuer hochmoderner Chips und Produkte). Das Chip-Gesetz schreibt keine bestimmten KPI für die Messung der kontinuierlichen Innovation vor, das antragstellende Unternehmen muss jedoch klare Innovationsparameter verwenden, um kontinuierliche Innovation vom Tagesgeschäft zu unterscheiden.

(d) *Investitionen in Bildung und Kompetenzen* (Nummer 2.4 des Antragsformulars): Der Antragsteller muss erläutern, wie sein Projekt die Talentpipeline der EU durch die Entwicklung und den Einsatz von Bildungs- und Qualifizierungsmaßnahmen und durch die Ausweitung des Pools an qualifizierten Arbeitskräften unterstützen wird.

Die Erläuterung sollte **5 000 Zeichen (rund drei Seiten) nicht überschreiten**.

Nachweise sollten in S-CIRCABC in den Ordner „02-IPF-OEF-compliance criteria“ hochgeladen werden.

Der Antragsteller sollte geplante Bildungs- und Qualifizierungsmaßnahmen nennen, durch die die Ausweitung des Pools an qualifizierten Arbeitskräften in der EU unterstützt werden soll. Der Antragsteller sollte klarstellen, wie zwischen üblichen Schulungen für Arbeitskräfte einerseits und Tätigkeiten, die speziell darauf abzielen, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu gewinnen, deren Kompetenzen für den Halbleitersektor der EU am besten geeignet sind und dort benötigt werden, andererseits unterschieden werden soll.

So könnte der Antragsteller beispielsweise seine Absicht näher erläutern, mit einer technischen Universität zusammenzuarbeiten, um die Sichtbarkeit von und das Interesse der Studierenden an Arbeitsplätzen im Halbleiterbereich zu steigern. Ebenso könnte der Antragsteller Partnerschaften mit Sachverständigen von Technologieforschungszentren erwähnen. Der Antragsteller kann auch Onboarding-Programme, Workshops und Schulungen vorstellen, die darauf abzielen, bestehende Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit den Kompetenzen für die Zukunft auszustatten. So dürfte beispielsweise in den Bereichen Ingenieurwesen und Fertigung die Nachfrage nach digitalen und analytischen Kompetenzen zunehmen. Schließlich könnte auch der Hinweis auf Karrierechancen für talentierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hilfreich sein.

C. *Geschäftsplan (Artikel 15 Absatz 2 Buchstabe b des Chip-Gesetzes)*

Drittens muss die Kommission anhand des Antrags den **Geschäftsplan** des Unternehmens nachvollziehen können, **um die finanzielle und technische Tragfähigkeit der Anlage zu beurteilen** (Nummer 3 des Antragsformulars). Der Geschäftsplan muss die gesamte Lebensdauer der Anlage abdecken und Informationen über etwaige öffentliche Mittel enthalten, die von Behörden oder von staatseigenen Unternehmen des Mitgliedstaats, in dem sich die Anlage befindet, oder von anderen (Nicht-)EU-Länder gewährt werden.

Die Kommission macht keine Vorgaben für ein bestimmtes Format solcher Unterlagen. Der Inhalt dieser Unterlagen sollte klar und deutlich sein.

Die Erläuterung sollte **15 000 Zeichen (d. h. bis zu zehn Seiten) nicht überschreiten**.

Nachweise sollten in S-CIRCABC in den Ordner „03-Business plan“ hochgeladen werden.

Alle hier bereitgestellten Informationen werden ausschließlich für die Zwecke des Chip-Gesetzes verwendet und fallen gemäß Artikel 339 AEUV sowie den internen Vorschriften der Kommission über den sicheren Umgang mit Daten (insbesondere Beschluss (EU, Euratom) 2015/443 der Kommission) unter das Berufsgeheimnis.

D. *Dokumentation der Erfahrung des Antragstellers (Artikel 15 Absatz 2 Buchstabe c des Chip-Gesetzes)*

Viertens muss die Kommission anhand des Antrags die **Erfahrung des Antragstellers** mit der Installation und dem Betrieb ähnlicher Anlagen beurteilen können (siehe Nummer 4 des Antragsformulars). Dies könnte durch die Vorlage eines **Tätigkeitsberichts** für die Vorjahre oder durch eine Beschreibung des Projektteams und der jeweiligen einschlägigen Erfahrung mit der Verwaltung ähnlicher Projekte und/oder dem Betrieb ähnlicher Anlagen nachgewiesen werden. Für den Fall, dass kein Tätigkeitsbericht verfügbar ist, schlägt die Kommission vor, einen solchen speziell für diesen Antrag zu erstellen und von einem gesetzlichen Vertreter bestätigen zu lassen.

Die vorgenannte Unterlage sollte in S-CIRCABC in den Ordner „04-Proven Experience“ hochgeladen werden.

E. *Nachweis für die Bereitschaft des Mitgliedstaats bzw. der Mitgliedstaaten, auf dessen bzw. deren Hoheitsgebiet(en) die Anlage gebaut würde, ihre Einrichtung zu fördern (Artikel 15 Absatz 2 Buchstabe d des Chip-Gesetzes)*

Fünftens muss die Kommission anhand des Antrags überprüfen können, ob der Antragsteller einen geeigneten **Nachweis für die Bereitschaft des Mitgliedstaats bzw. der Mitgliedstaaten**, in dem bzw. denen der Antragsteller seine Anlage anzusiedeln gedenkt, **die Einrichtung einer solchen Anlage zu unterstützen**, vorgelegt hat (siehe Nummer 5 des Antragformulars).

Dabei könnte es sich um ein Schreiben des Mitgliedstaats (z. B. des gemäß der nationalen Kompetenzverteilung zuständigen Ministers) oder um eine vorläufige Entscheidung des Mitgliedstaats handeln, die Einrichtung der Anlage des Antragstellers (auf finanzielle, administrative und/oder sonstige Weise) zu unterstützen.

Es reicht nicht aus, lediglich nachzuweisen, dass der Mitgliedstaat allgemein beabsichtigt, Anlagen zu unterstützen, die der geplanten Anlage ähneln. Die Unterstützung des Mitgliedstaats kann, muss aber nicht mit einer monetären Bezuschussung verbunden sein.

Die Unterlage sollte in S-CIRCABC in den Ordner „05-Member State support“ hochgeladen werden.

F. *Vorliegen von politischen Maßnahmen und Plänen im Bereich des geistigen Eigentums (Artikel 15 Absatz 2 Buchstabe e des Chip-Gesetzes)*

Innovative High-Tech-Unternehmen sind zunehmend der Entwendung von vertraulichen Informationen, Geschäftsgeheimnissen und geschützten Daten ausgesetzt, wie etwa Diebstahl geistigen Eigentums, unerlaubte Vervielfältigung, erzwungene Technologietransfers, Wirtschaftsspionage oder Verstöße gegen Vertraulichkeitsanforderungen, und zwar von innerhalb, vor allem aber von außerhalb der Union. Jüngste Entwicklungen (z. B. zunehmendes Outsourcing, längere globale Wertschöpfungsketten und der verstärkte Einsatz von Informations- und Kommunikationstechnik) haben dieses Risiko erhöht. Die unrechtmäßige Aneignung, Nutzung oder Offenlegung von vertraulichen Informationen, Geschäftsgeheimnissen und geschützten Daten beeinträchtigt die Fähigkeit des Unternehmens, aus Innovationsanstrengungen Vorreiterrenditen zu erzielen.

Der Antragsteller muss (siehe Nummer 6 des Antragsformulars) nachweisen, dass geeignete Strategien einschließlich technischer Schutzvorkehrungen und Durchführungsmaßnahmen bestehen, die auf Folgendes abzielen:

(a) **Gewährleistung des Schutzes von nicht offengelegten Informationen**;

(b) **Gewährleistung des Schutzes von Rechten des geistigen Eigentums**, insbesondere um die unbefugte Offenlegung von Geschäftsgeheimnissen oder die Preisgabe sensibler neu aufkommender Technologien zu verhindern.

Der Antragsteller kann beispielsweise interne Unternehmensstrategien oder Mitarbeiterhandbücher, Verträge zwischen Inhabern von Rechten des geistigen Eigentums und Zulieferern, z. B. Fertigungsanlagen, Konformitätsbescheinigungen oder Branchenkodizes vorlegen, unabhängig davon, ob diese freiwillig oder verbindlich sind.

Es ist vorzuziehen, dass die bestehenden Unternehmensregelungen einfach formuliert und in klarer, deutlicher Sprache mit genau festgelegten Maßnahmen verfasst werden. Aus den Maßnahmen sollte klar hervorgehen, wie die Anweisungen aus den Unternehmensstrategien zum angemessenen Schutz von Informationen, Daten und Rechten des geistigen Eigentums umgesetzt werden.

Die Nachweise des Schutzes dieser beiden Aspekte sollten in S-CIRCABC in den Ordner „06-Protection of sensitive information“ hochgeladen werden.

G. *Verpflichtung zur vorrangigen Behandlung von Aufträgen in Krisenzeiten (Artikel 26 des Chip-Gesetzes)*

Ein Unternehmen, das den IPF- oder OEF-Status erlangt hat, ist rechtlich verpflichtet, die Bestimmungen des Chip-Gesetzes über die vorrangige Behandlung von Aufträgen in Krisenzeiten einzuhalten. Im Zuge des Antragsverfahrens werden die Unternehmen unter Nummer 2.2 des Antragsformulars aufgefordert, ausdrücklich zu bestätigen, dass Ihnen die Anforderung bekannt ist, der sie aufgrund des IPF- und OEF-Status in Bezug auf vorrangige Behandlung von Aufträgen gemäß Artikel 26 des Chip-Gesetzes unterliegen.

3. **Nach welchem Verfahren bewertet die Kommission die Anträge?**

Im Einklang mit Artikel 15 des Chip-Gesetzes bewertet die Kommission den Antrag in einem fairen und transparenten Verfahren auf der Grundlage der in der Antwort auf Frage 2 genannten Kriterien und Beispiele und nach dem in Artikel 15 des Chip-Gesetzes beschriebenen Verfahren. **Die Bewertung gliedert sich in vier Phasen**, wie nachstehend beschrieben. Die **für jede Phase angegebene Frist trägt der Tatsache Rechnung, dass die Kommission innerhalb von sechs Monaten nach Eingang eines vollständigen Antrags diesen bearbeiten und darüber entscheiden muss**. Ein unvollständiger Antrag kann – in jeder Phase des Verfahrens – zu Verzögerungen im Antragsverfahren führen.

A. *Antragseingang und erste Bewertungsstufe (Überprüfung des Online-Formulars)*

Über die Futurium-Plattform können Unternehmen ihr Interesse an der Beantragung des IPF- oder OEF-Status bekunden, indem sie ein **Online-Formular** mit ihren Identifizierungsangaben und einer kurzen Beschreibung der Anlage und des Projekts ausfüllen (weitere Einzelheiten siehe Anhang). Sobald der Antrag eingereicht wurde, erhält der Antragsteller von der Futurium-Plattform automatisch eine Bestätigung, und die Kommission wird benachrichtigt.

Sobald der Antragsteller benachrichtigt wurde, prüft die Kommission, ob das Online-Formular ordnungsgemäß ausgefüllt wurde. In dieser Phase des Verfahrens kann die Kommission über die im Online-Formular angegebene E-Mail-Adresse mit dem Unternehmen Verbindung aufnehmen, um erforderlichenfalls zusätzliche Angaben oder Informationen anzufordern.

Sobald die Kommission in der Lage ist, die Identität und die Absicht des Antragstellers zu überprüfen, wird der Antragsteller zu einer Untergruppe in Futurium eingeladen, die nur für ihn und die Kommission zugänglich ist. Innerhalb dieser Untergruppe teilt die Kommission dem Antragsteller ihre Entscheidung mit und übermittelt ihm den Link zur gesicherten Plattform S-CIRCABC, auf der der Antragsteller die Beantragung des IPF- oder OEF-Status fortsetzen kann. In S-CIRCABC wird der Antragsteller aufgefordert, den ausgefüllten Antrag und die zugehörigen Nachweise hochzuladen.

Sobald der Antragsteller alle erforderlichen Unterlagen und Nachweise hochgeladen hat, bestätigt ihm die Kommission in der Futurium-Untergruppe, dass sein Antrag vollständig ist und nun die erste Bewertungsstufe beginnt.

Die nachstehenden Fristen dienen als Anhaltspunkt und beruhen auf einer Schätzung der für die Bewertung des Antrags in jeder Phase des Verfahrens benötigten Zeit.

— Die Phase vom Antragseingang bis zur ersten Bewertungsstufe sollte **zwei Wochen** dauern.

B. *Zweite Bewertungsstufe (Vollständigkeit des Antrags)*

Zu diesem Zeitpunkt bewertet die Kommission, ob **alle Unterlagen vorliegen und technisch lesbar sind**. Ist die Kommission der Auffassung, dass die im Antrag enthaltenen Informationen unvollständig sind, so fordert sie den Antragsteller in der Futurium-Untergruppe auf, die zur Vervollständigung des Antrags erforderlichen zusätzlichen Informationen unverzüglich nachzureichen.

— Sobald die Kommission davon ausgeht, dass der Antrag **vollständig** ist und alle relevanten Unterlagen und Informationen enthält, teilt sie dem Antragsteller **innerhalb von zwei Wochen** in der Futurium-Untergruppe den Beginn der dritten und abschließenden Bewertungsstufe mit.

C. *Dritte Bewertungsstufe (Einhaltung der Kriterien für den IPF- und OEF-Status)*

Bei der dritten Bewertungsstufe wird die **Einhaltung der Kriterien für den IPF- oder OEF-Status und die Tragfähigkeit des Projekts** geprüft, wie in der Antwort auf Frage 2 erläutert. Für Letzteres bewertet die Kommission den Geschäftsplan, aus dem die finanzielle Tragfähigkeit des Projekts hervorgeht, die Dokumentation der Erfahrung des Antragstellers sowie das Schreiben oder den Nachweis für die Bereitschaft des Mitgliedstaats bzw. der Mitgliedstaaten, auf dessen bzw. deren Hoheitsgebiet(en) die Anlage gebaut würde, die Einrichtung einer solchen Anlage zu fördern. Diese Dokumentation ermöglicht es der Kommission, den Status vor allem jenen Projekten zu gewähren, die nachgewiesene Erfolgsaussichten haben.

— Die dritte Bewertungsstufe kann je nach Komplexität des eingereichten Projekts und dem Vorliegen einer früheren Bewertung im Rahmen eines Beihilfeverfahrens zwischen drei und vier Monaten der insgesamt sechs Monate in Anspruch nehmen.

D. *Empfehlung des Europäischen Halbleitergremiums und Beschlussfassung*

Sobald die Kommission ihre Bewertung abgeschlossen hat, konsultiert sie das **Europäische Halbleitergremium** auf der Grundlage der vom Antragsteller vorgelegten nicht vertraulichen Informationen und im Einklang mit dem für die Kommission geltenden Rahmen für die Informationssicherheit und allen Vertraulichkeitsvorschriften (siehe unten).

Unter Berücksichtigung der Standpunkte des Europäischen Halbleitergremiums schließt die Kommission ihre Bewertung ab und teilt dem Antragsteller einen **Beschluss der Kommission per E-Mail** mit. Der Beschluss wird später auch in Futurium veröffentlicht. In der öffentlichen Fassung des Beschlusses werden alle Verweise auf vertrauliche Informationen gestrichen.

In dem **Beschluss der Kommission** wird der gewährte Status (IPF oder OEF) und die Dauer des Status auf der Grundlage der voraussichtlichen Lebensdauer des Projekts festgelegt.

— Der Beschluss ergeht **spätestens sechs Monate nach Eingang eines vollständigen Antrags** (siehe auch zweite Bewertungsstufe).



Abbildung 1

Bewertungsverfahren für Anträge auf Gewährung des IPF- und OEF-Status

4. **Überwacht die Kommission nach Gewährung des IPF- oder OEF-Status die Durchführung des Projekts?**

Die Kommission überwacht die Fortschritte bei der Einrichtung und dem Betrieb der IPF oder OEF. Insbesondere kann die Kommission von dem Unternehmen verlangen, (jährlich oder in anderen Zeitabständen, je nach Gesamtdauer des Projekts) einen Bericht vorzulegen, in dem die Fortschritte des Projekts und die fortgesetzte Einhaltung der wesentlichen Kriterien und Verpflichtungen, auf deren Grundlage der IPF- oder OEF-Status gewährt wurde, dargelegt werden. Die Kommission unterrichtet das Europäische Halbleitergremium regelmäßig über S-CIRCABC.

A. *Statusänderungen*

Vom Betreiber der Anlage veranlasste Änderungen

In hinreichend begründeten Fällen kann der Betreiber der Anlage, die den IPF- oder OEF-Status erlangt hat, bei der Kommission (über die Futurium-Untergruppe und erforderlichenfalls anhand von in S-CIRCABC hochgeladenen Nachweisen) einen begründeten Antrag stellen, **die Gewährungsdauer des Status zu überprüfen oder seine Durchführungspläne** im Hinblick auf die Einhaltung der Anforderungen **zu ändern**. Die Begründungen und/oder die externen Umstände werden von der Kommission im Einzelfall geprüft. Die Kommission kann die Dauer des mit ihrem ursprünglichen Beschluss gewährten Status überdenken oder die Änderung der Durchführungspläne akzeptieren.

Von der Kommission veranlasste Änderungen

Stellt die Kommission fest, dass eine Anlage die in Artikel 13 und Artikel 14 des Chip-Gesetzes festgelegten Anforderungen an eine IPF oder einen OEF nicht mehr erfüllt, so fordert sie den Betreiber auf, dazu Stellung zu nehmen und geeignete Abhilfemaßnahmen vorzuschlagen.

B. *Aufhebung des Status*

Die Kommission kann einen Beschluss über die Anerkennung des Status einer IPF oder eines OEF aufheben, wenn die Anerkennung auf einem **Antrag beruhte, der unrichtige Informationen enthielt, oder** wenn **die Anlage** trotz des Abschlusses des Verfahrens **die Anforderungen für die Gewährung des Status nicht erfüllt**. Bevor die Kommission einen solchen Beschluss fasst, konsultiert sie das Europäische Halbleitergremium und teilt ihm die Gründe für die vorgeschlagene Aufhebung mit.

Der Betreiber der Anlage hat das Recht, gegen den Beschluss der Kommission, einen Status aufzuheben, Rechtsmittel einzulegen. Anlagen, deren Status aufgehoben wurde, verlieren alle mit der Anerkennung dieses Status verbundenen Rechte, die sich aus dem Chip-Gesetz ergeben. Gemäß Artikel 15 Absatz 8 des Chip-Gesetzes **unterliegen solche Anlagen jedoch während des Zeitraums, der bei der Gewährung oder der Überprüfung des Status ursprünglich vorgesehen war, weiterhin der** in Artikel 26 Absatz 1 des Chip-Gesetzes festgelegten **Verpflichtung, einen Auftrag für krisenrelevante Produkte anzunehmen und vorrangig zu behandeln** (im Folgenden „vorrangiger Auftrag“), wenn die Krisenstufe aktiviert wird.

5. **Wie funktioniert die elektronische Übermittlung des Antrags?**

Antragsteller, die den IPF- oder OEF-Status anstreben, werden aufgefordert, alle Unterlagen in elektronischer Form und vorzugsweise auf elektronischem Wege einzureichen. Eine persönliche Abgabe, die nur in Ausnahmefällen akzeptiert wird, sollte innerhalb der Öffnungszeiten bei der auf der Kontaktseite in Futurium angegebenen Anschrift erfolgen.

Für die Anerkennung ihres (geplanten) Projekts als IPF oder OEF können einzelne Unternehmen oder ein Unternehmenskonsortium ihren Antrag direkt auf der Gemeinschaftsplattform **Futurium** bei der Kommission einreichen. Auf der Futurium-Plattform sollte der Antragsteller die folgenden wichtigen Informationen in das Online-Formular eingeben:

— Name des Unternehmens und Akronym (falls zutreffend),

— Art des Antrags (IPF oder OEF),

— Hauptansprechpartner (Betreiber der Anlage oder Projektleiter),

— Herkunftsland,

— Ansiedlungsmitgliedstaat(en),

— kurze Zusammenfassung des Unternehmens und des Projekts (höchstens 5 000 Zeichen),

— nicht vertrauliche Zusammenfassung der Anlage oder des Projekts und der Zielsetzungen (höchstens 5 000 Zeichen). Die Zusammenfassung darf keine vertraulichen Informationen oder Geschäftsgeheimnisse enthalten. Diese nicht vertrauliche Zusammenfassung wird im Einklang mit dem Rahmen für die Informationssicherheit der Kommission und allen Vertraulichkeitsvorschriften (siehe Abschnitt unten) dem Europäischen Halbleitergremium zur Einsichtnahme übermittelt, bevor der endgültige Beschluss getroffen wird.

Sobald dieses Formular eingereicht wurde, werden die Kommission und der Antragsteller automatisch benachrichtigt, und die Kommission kann mit der Überprüfung der im Online-Formular übermittelten Informationen beginnen. Sobald die Kommission in der Lage ist, die Identität und die Absicht des Antragstellers zu überprüfen, erstellt sie in **S-CIRCABC** – einer Webanwendung, die den sicheren Austausch von Dokumenten, Informationen und Ressourcen in privaten Arbeitsbereichen ermöglicht – einen Ordner. Dieser Ordner ist nur für die Kommission und den Antragsteller sichtbar. In diesem Hauptordner erstellt die Kommission eine Reihe von Unterordnern, einen für jeden der in Beantwortung der Frage 3 erläuterten Bewertungsschritte. Anschließend lädt die Kommission den Antragsteller zu einer Futurium-Untergruppe ein und stellt ihm dort die Informationen und Unterlagen für die nächsten Schritte des Antragsverfahrens zur Verfügung. Der Antragsteller erhält einen Link für den Zugriff auf S-CIRCABC und die einzelnen Ordner und Unterordner sowie das Antragsformular, das auszufüllen und zusammen mit den in diesem Leitfaden genannten Nachweisen hochzuladen ist. Nachdem das Unternehmen alle benötigten Unterlagen in S-CIRCABC hochgeladen hat, sollte es dies der Kommission in der Futurium-Untergruppe mitteilen.

Im Allgemeinen sind alle Unterlagen über S-CIRCABC einzureichen. Die Unterlagen werden in allen Amts- und Arbeitssprachen der Organe der Union angenommen. Die Antragsteller tragen die volle Verantwortung für den Inhalt der Unterlagen.

Anträge, die montags bis donnerstags vor 17.00 Uhr Brüsseler Ortszeit sowie an Freitagen und Tagen vor den Feiertagen der Kommission vor 16.00 Uhr Brüsseler Ortszeit elektronisch eingehen, werden am selben Tag bearbeitet und haben somit im Einklang mit der bisherigen Praxis bei Einreichung in Papierform das Eingangsdatum als Einreichungsdatum. Anträge, die nach 17.00 Uhr bzw. 16.00 Uhr eingehen, werden am nächsten Arbeitstag bearbeitet, der dann als Tag der Einreichung gilt.

Vertraulichkeit und personenbezogene Daten

Nach Artikel 339 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV) sind die Kommission, die Mitglieder der Organe der EU, die Mitglieder der Ausschüsse sowie die Beamten und sonstigen Bediensteten der Union verpflichtet, auch nach Beendigung ihrer Amtstätigkeit Auskünfte, die unter das Berufsgeheimnis fallen, nicht preiszugeben; dies gilt insbesondere für Auskünfte über Unternehmen sowie deren Geschäftsbeziehungen oder Kostenelemente.

Darüber hinaus dürfen gemäß Artikel 32 des Chip-Gesetzes (Verordnung (EU) 2023/1781) die im Zuge seiner Durchführung erlangten Informationen auch nur für dessen Zwecke verwendet werden und sind zudem durch das einschlägige Unions- und nationale Recht geschützt. Insbesondere im Hinblick auf den Anwendungsbereich dieses Leitfadens fallen Informationen, die gemäß Artikel 15 und Artikel 26 Absatz 3 erlangt werden, unter das Berufsgeheimnis und genießen den Schutz, der durch die für die Organe der EU geltenden Vorschriften und das einschlägige nationale Recht gewährt wird, einschließlich des Auslösens der bei Verstößen gegen diese Vorschriften anwendbaren Bestimmungen.

Nach dem Chip-Gesetz gewährleisten die Kommission und die nationalen Behörden, ihre Beamten, ihre Bediensteten und sonstige Personen, die unter Aufsicht dieser Behörden tätig sind, ferner die Vertraulichkeit der bei der Durchführung ihrer Aufgaben und Tätigkeiten erlangten Daten, sodass insbesondere Rechte des geistigen Eigentums und sensible Geschäftsinformationen oder Geschäftsgeheimnisse geschützt werden. Diese Verpflichtung gilt für alle Vertreter der Mitgliedstaaten, Beobachter, Experten und sonstige Personen, die an Sitzungen des Europäischen Halbleitergremiums gemäß Artikel 28 teilnehmen, sowie die Mitglieder des Halbleiterausschusses gemäß Artikel 38 Absatz 1.

Sollten Antragsteller der Auffassung sein, dass ihre Interessen beeinträchtigt würden, wenn die geforderten Informationen veröffentlicht oder an andere Beteiligte weitergegeben würden, so übermitteln sie die betreffenden Angaben in einer gesonderten Anlage mit dem deutlichen Vermerk „Geschäftsgeheimnis“ auf jeder Seite. Antragsteller sollten ferner erläutern, warum diese Informationen nicht weitergegeben oder veröffentlicht werden sollen.

Mit dem Antragsformular übermittelte personenbezogene Daten [20] werden im Einklang mit der Verordnung (EU) 2018/1725 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. Oktober 2018 zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten durch die Organe, Einrichtungen und sonstigen Stellen der Union, zum freien Datenverkehr und zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 45/2001 und des Beschlusses Nr. 1247/2002/EG [21] verarbeitet.

IV. **Checkliste und IT-Werkzeuge**

A. *Checkliste*

Bitte beachten Sie bei der Beantragung des IPF- oder OEF-Status die folgende Checkliste: Die Vorantragsphase ist nicht verpflichtend (Schritt 1). Bevor Schritt 2 begonnen und das Antragsformular in S-CIRCABC ausgefüllt werden kann, muss die Kommission Ihr Online-Formular in Futurium positiv bewertet haben.

Schritt	Aufgabe	Erforderliche Informationen	Erledigt
1. **(FAKULTATIV) Vorbeantragung des IPF- oder OEF-Status**	(FAKULTATIV) Kontaktieren Sie die Kommission unter CNECT-IPF-OEF@ec.europa.eu	Entfällt	
2. **Beantragung des IPF- oder OEF-Status – Interessensbekundung.**	Füllen Sie das Online-Formular in Futurium aus. Klicken Sie dazu auf die gelbe Schaltfläche „*Application for integrated production facility and open EU foundry* (IPF- und OEF-Beantragung)“.	Name des Unternehmens oder Konsortiums	
		Akronym des Projekts (falls zutreffend)	
		Art des Antrags (IPF oder OEF)	
		Vor- und Nachname, Funktion, Organisation und E-Mail-Adresse des Betreibers der Anlage/des Projektleiters	
		EU-Mitgliedstaat(en), in dem bzw. denen die Anlage errichtet werden soll	
		Kurze Vorstellung des Unternehmens/Konsortiums (höchstens 5 000 Zeichen)	
		Zusammenfassung der Beschreibung der Anlage oder des Projekts und der Zielsetzungen (höchstens 5 000 Zeichen)	

[20] DPR-EC-22368.

[21] ABl. L 295 vom 21.11.2018, S. 39, abrufbar unter https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:32018R1725. Eine Datenschutzerklärung zu Fusionskontrolluntersuchungen finden Sie unter https://ec.europa.eu/competition-policy/index/privacy-policy-competition-investigations_en.

Schritt	Aufgabe	Erforderliche Informationen	Erledigt
		Nicht vertrauliche Zusammenfassung der Beschreibung der Anlage oder des Projekts und der Zielsetzungen (höchstens 5 000 Zeichen). Die Zusammenfassung darf keine vertraulichen Informationen oder Geschäftsgeheimnisse enthalten. Diese Zusammenfassung soll unter Einhaltung aller Vertraulichkeitsregeln dem Europäischen Halbleitergremium zur Einsichtnahme übermittelt werden, bevor die endgültige Entscheidung getroffen wird.	
3. **Beantragung des IPF- oder OEF-Status – Nachweis der Einhaltung**	Füllen Sie das Antragsformular aus und laden Sie es im PDF-Format in S-CIRCABC in den Ordner „00-application form“ hoch. **Bitte beachten Sie die Vorgaben in diesem Leitfaden in Bezug auf die Länge des Textes.**	Beschreibung der Anlage unter Berücksichtigung der Definition des Begriffs „neuartig“ und Erläuterung, worin sich das Projekt von bestehenden Anlagen und geplanten Projekten – mit oder ohne öffentliche Unterstützung – im Europäischen Wirtschaftsraum unterscheidet. **Nachweise können Folgendes umfassen:** — z. B. einschlägige Marktstudien und Berichte über die Geschäftstätigkeit und die Produkte der Anlage, interne Projektdokumentationen und/oder Unterlagen, die der Verwaltungsrat für die interne Entscheidungsfindung verwendet, usw. — Nachweise sind in S-CIRCABC in den Ordner „01-First-of-a-kind“ hochzuladen.	
		Erläuterung der mittel- bis langfristigen positiven Auswirkungen und Ausstrahlungseffekte auf die Halbleiter-Wertschöpfungskette der EU. **Nachweise:** Nicht festgelegt. **Nur für OEFs:** Angabe der Produktionskapazität der Anlage im Front-End- oder Back-End-Bereich	

Schritt	Aufgabe	Erforderliche Informationen	Erledigt
3. **Beantragung des IPF- oder OEF-Status – Nachweis der Einhaltung**	Füllen Sie das Antragsformular aus und laden Sie es im PDF-Format in S-CIRCABC in den Ordner „00-application form“ hoch. **Bitte beachten Sie die Vorgaben in diesem Leitfaden in Bezug auf die Länge des Textes.**	Gewährleistung, dass die Anlage keinen von Drittstaaten auferlegten Verpflichtungen unterliegt. **Nachweise:** — schriftliche Erklärung, einschließlich der rechtlichen oder politischen Grundlage einer solchen Verpflichtung, — Nachweise sind in S-CIRCABC in den Ordner „02-IPF-OEF-compliance criteria“ hochzuladen.	
		Bestätigung der Verpflichtung, vorrangige Aufträge gemäß Artikel 26 des Chip-Gesetzes anzunehmen. **Nachweise**: Nicht erforderlich.	
		Erklärung der Selbstverpflichtung des Unternehmens zur kontinuierlichen Innovation. **Nachweise:** Nicht festgelegt.	

Schritt	Aufgabe	Erforderliche Informationen	Erledigt
		Beschreibung der Absicht, in Bildung und Kompetenzen zu investieren. **Nachweise können Folgendes umfassen:** — z. B. Links zu Agendas, Schulungen, Partnerschaften usw. — Nachweise sind in S-CIRCABC in den Ordner „02-IPF-OEF-compliance criteria“ hochzuladen.	
		Beschreibung des Geschäftsplans der Anlage. **Nachweise:** — Format nicht festgelegt, muss aber nutzerfreundlich sein (z. B. Excel). — Nachweise sind in S-CIRCABC in den Ordner „03-Business Plan“ hochzuladen.	

Schritt	Aufgabe	Erforderliche Informationen	Erledigt
3. **Beantragung des IPF- oder OEF-Status – Nachweis der Einhaltung**	Füllen Sie das Antragsformular aus und laden Sie es im PDF-Format in S-CIRCABC in den Ordner „00-application form“ hoch. **Bitte beachten Sie die Vorgaben in diesem Leitfaden in Bezug auf die Länge des Textes.**	Dokumentation der Erfahrung mit der Anlage (einschließlich eines Tätigkeitsberichts, in dem die Tätigkeiten der Anlage in den Vorjahren beschrieben werden, oder – falls nicht verfügbar – einer gesetzlichen Bescheinigung). **Nachweise:** — Tätigkeitsbericht oder Beschreibung des Projektteams und der entsprechenden Erfahrung. — Nachweise sind in S-CIRCABC in den Ordner „04-Proven Experience“ hochzuladen.	
		Gewährleistung der Unterstützung der Einrichtung der Anlage durch den Mitgliedstaat/die Mitgliedstaaten, in dem bzw. denen diese angesiedelt werden soll. **Nachweise können Folgendes umfassen:** — z. B. gesetzliche Bescheinigung, Schreiben des Mitgliedstaats, vorläufige Entscheidung, Unterlagen über staatliche Beihilfen, — Nachweise sind in S-CIRCABC in den Ordner „05-Member State support“ hochzuladen.	

Schritt	Aufgabe	Erforderliche Informationen	Erledigt
		Beschreibung bestehender geeigneter Strategien und Maßnahmen zum Schutz vertraulicher Informationen und der Rechte des geistigen Eigentums mit einer klaren Erläuterung, wie die Anweisungen in den Strategien umzusetzen sind. **Nachweise können Folgendes umfassen:** — z. B. interne Unternehmensstrategien oder Mitarbeiterhandbücher, Verträge zwischen Inhabern von Rechten des geistigen Eigentums und Zulieferern, z. B. Fertigungsanlagen, Konformitätsbescheinigungen oder Verhaltenskodizes der Branche. — Nachweise sind in S-CIRCABC in den Ordner „06-Protection of sensitive information“ hochzuladen.	

B. *IT-Werkzeuge für das Antragsverfahren*

Eine Voraussetzung für den Zugang zu den IT-Werkzeugen, die für das Verfahren zur Erlangung des IPF- und OEF-Status verwendet werden (Futurium und S-CIRCABC), ist ein **EU-Login**.

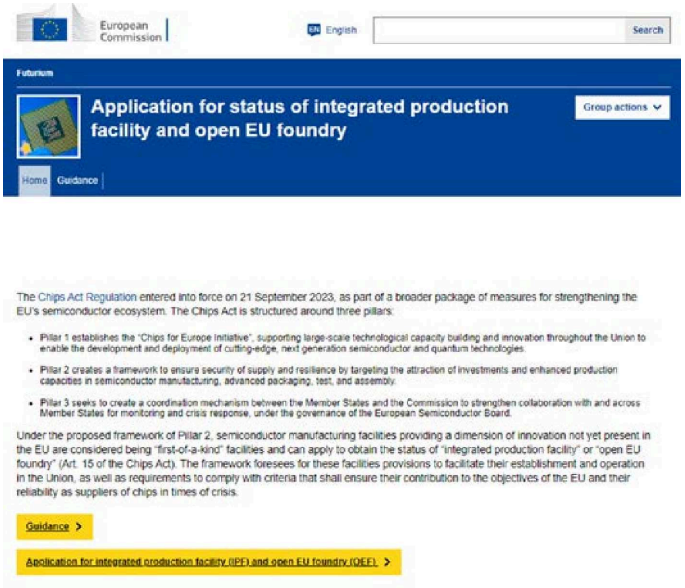
— Wie Sie **ein neues EU-Login erstellen** können, erfahren Sie auf folgender Seite: https://ecas.ec.europa.eu/cas/eim/external/register.cgi

— Wenn Sie technische Unterstützung benötigen, besuchen Sie bitte auch den besonderen Bereich für externe Nutzer: https://europa.eu/!rdDfPj

Futurium

— Sobald Ihr EU-Login erstellt wurde, können Sie über folgende URL **auf Futurium zugreifen**: https://futurium.ec.europa.eu/en/application-status-integrated-production-facility-and-open-eu-foundry.

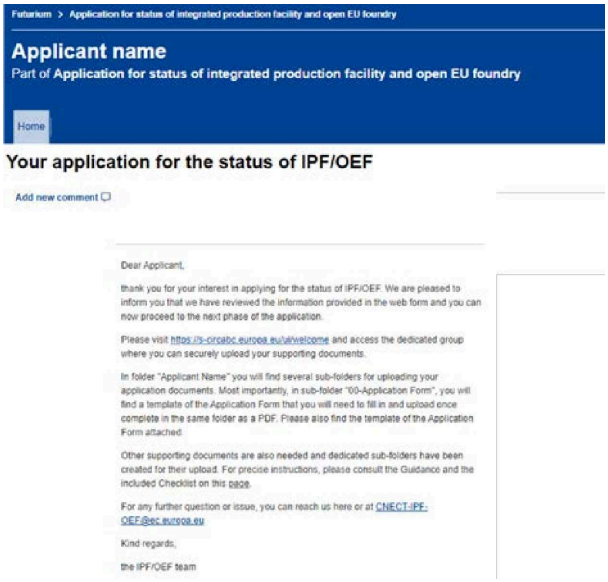
Nach der Anmeldung sehen Sie die **Startseite** und können auf den **Leitfaden** und das **Online-Formular** zugreifen, um Ihr Interesse zu bekunden. Eine vollständige Übersicht über die erforderlichen Informationen findet sich in der **Checkliste** im Anhang des Leitfadens (siehe Screenshot unten).



Sobald die im Online-Formular bereitgestellten Informationen bestätigt worden sind, werden Sie einer **Untergruppe** hinzugefügt, die nur für Sie und die Kommission sichtbar ist. Dies ist der wichtigste Kommunikationskanal während des gesamten Antragsverfahrens (siehe Beispiel im Screenshot unten).

Bitte laden Sie keine sensiblen oder vertraulichen Informationen in Futurium hoch.

Solche Informationen sollten Sie nur über S-CIRCABC und erforderlichenfalls per gesicherter E-Mail übermitteln.



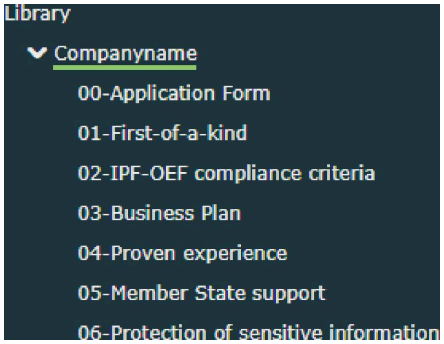
— Weitere Informationen zu den Hauptfunktionen von Futurium finden Sie im **Benutzerleitfaden** unter https://futurium.ec.europa.eu/en/documentation.

S-CIRCABC

Neben dem erforderlichen EU-Login ist für diese Anwendung der Zugang zu S-CIRCABC nur mit **Zwei-Faktor-Authentifizierung** möglich. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie Ihr EU-Login entsprechend konfigurieren, indem Sie eine Mobilfunknummer hinzufügen.

— Sobald Ihr EU-Login erstellt wurde, können Sie über folgende URL **auf S-CIRCABC und die Ihnen zugeteilte Gruppe zugreifen**: https://s-circabc.europa.eu/ui/welcome.

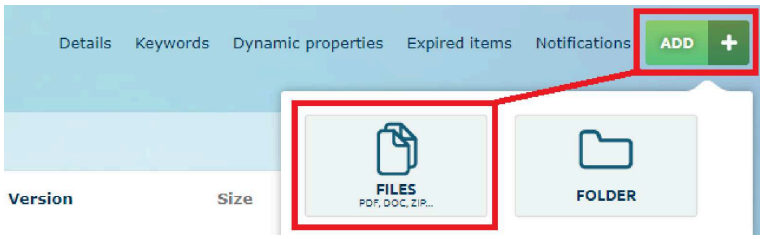
Nach der Anmeldung sehen Sie im Bereich **„Library" (Bibliothek)** die folgende Ordnerstruktur:



Bitte **laden Sie die Nachweise** in die entsprechenden Ordner **hoch**, wie im Leitfaden angegeben.

Eine vollständige Übersicht über die Unterlagen und Ordner findet sich in der **Checkliste** im Anhang des Leitfadens. Bitte beachten Sie, dass das **ausgefüllte Antragsformular in S-CIRCABC in den Ordner „00-application form“ hochgeladen werden muss**.

Um Unterlagen hochzuladen, klicken Sie bitte auf den entsprechenden Ordner oder Unterordner und klicken Sie auf „ADD“ (Hinzufügen) und wählen Sie „FILES“ (Dateien) aus (siehe Screenshot unten).



Für weitere Informationen oder bei Fragen wenden Sie sich bitte an die Direktion Künstliche Intelligenz und digitale Industrie in der GD CNECT über folgendes Funktionspostfach: CNECT-IPF-OEF@ec.europa.eu